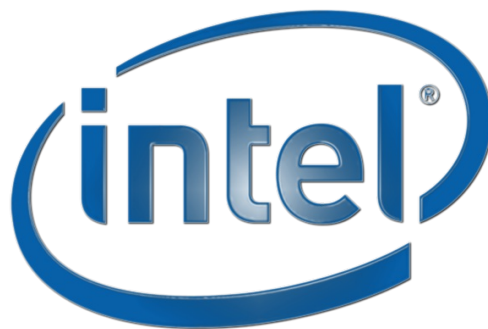




Intel Broadwell e Skylake, facciamo il punto

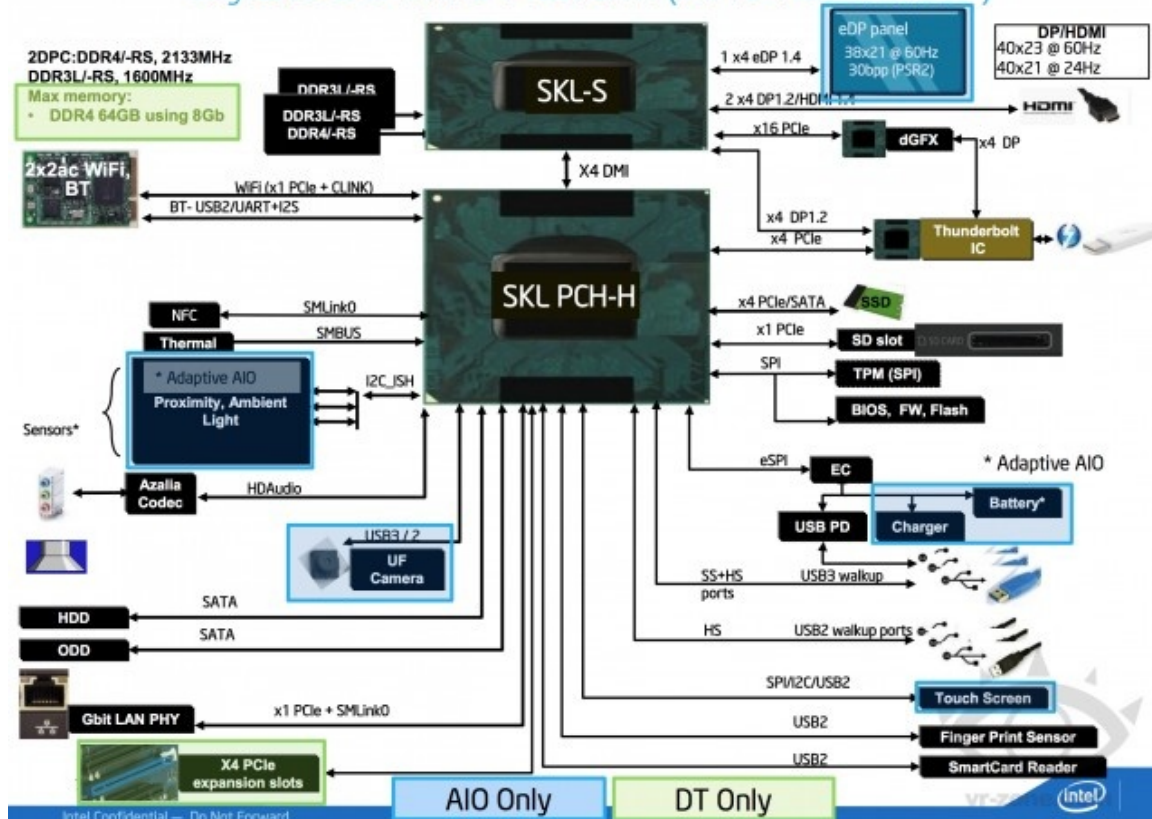
...



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/6725/intel-broadwell-e-skylake-facciamo-il-punto-.htm>)

Apparse in rete nuove informazioni relative a caratteristiche e data di lancio.

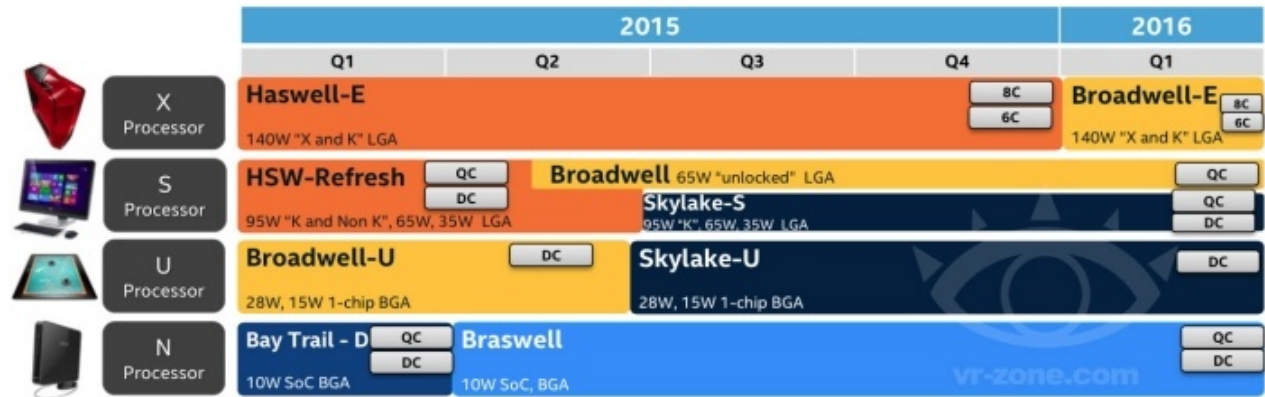
Skylake-S DT/AIO Platform (All IO Possibilities)



Secondo quanto riportato sul sito VR-Zone e ripreso dai ragazzi di [WCCFtech \(http://wccftech.com/intel-2015-2016-roadmap-reveals-skylake-s-unlocked-processors-q3-2015-65w-broadwell-kseries-q2-](http://wccftech.com/intel-2015-2016-roadmap-reveals-skylake-s-unlocked-processors-q3-2015-65w-broadwell-kseries-q2-)

[broadwelle-arrives-q1-2016/](#)), sembra che nel Q2 2015 ci saranno diversi importanti aggiornamenti per quanto concerne la lineup dei chipset e delle CPU Intel, con il lancio effettivo sul mercato di soluzioni desktop con processo produttivo a 14nm.

Ma le notizie più interessanti riguardano Skylake in versione "S" e "K", attese per Q3 2015, la prima con moltiplicatore bloccato e TDP compreso tra 35 e 65W, mentre la seconda con moltiplicatore sbloccato e TDP di 95W.



Skylake necessiterà , però, non solo di nuovi chipset, nello specifico Z170 e H170 nome in codice Sunrise Point per la fascia alta e H110, B150, Q170 e Q150 per quella media e bassa, ma anche di un differente socket rispetto a Broadwell, denominato LGA 1151.

Per quanto concerne Z170 le novità consistono essenzialmente, a parte il supporto alle memorie DDR4, nella gestione di 20 linee PCI Express 3.0 rispetto alle 16 di Z97, nel maggior numero di porte USB SuperSpeed (10), nella presenza di 3 SATA Express o 2 più 1 M.2.